

# Üretim Yetenekleri

## Production Capabilities



SDT kendi bünyesi içinde kabla j üretimi kart dizgi konformal kaplama ve elektronik kutu montaj işlemlerini yürütmektedir.

• **Uygulanan standartlar:**

- MIL-STD-454 İşçilik Standardı
- MIL-STD-130 Ürün Tanımlaması ve İzlenebilirliği
- Lehim İşçiliği için MIL-STD-2000
- IPC-J-STD-001D Elektronik Üretim Standardı
- IPC-A-610 Kablo ve Kabla j Takımları İçin

- Kabul Edilebilirlik Standardı
- IPC 7711-7721 Rework/ Repair and Modification Program
  - IPC /WHMA-A-620 Requirements and Acceptance for Cable and Wire Harness Assemblies

**SDT has in-house harness electronic board assembly conformal coating and mechanical assembly capabilities.**

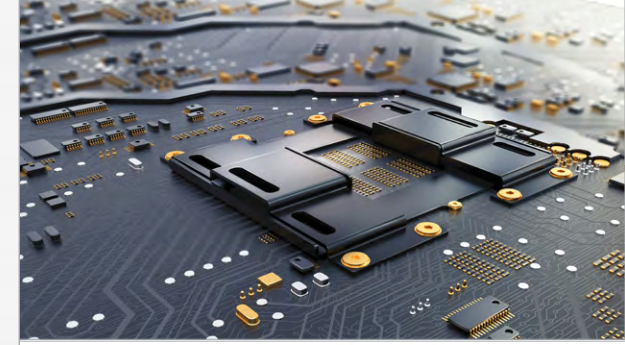
• **The Standards applied:**

- MIL-STD-454 Workmanship Standard
- MIL-STD-130 Product Definition and Traceability
- MIL-STD-2000 for Soldering Process
- IPC-J-STD-001D Electronic Assembly
- Cable and Cable Set Acceptance Standard

- IPC 7711-7721 Rework/ Repair and Modification Program
- IPC /WHMA-A-620 Requirements and Acceptance for Cable and Wire Harness Assemblies

# Üretim Yetenekleri

## Production Capabilities



### Üretim Aktiviteleri

- IPC Standartlarında tanımlı her tür DIP, SMD, BGA elektronik komponent dizgisi
  - 0402, 0603, 0805 ve daha büyükdirenc ve kapasitör dizgisi
  - QFN, QFP, TQFN, TQFP, BGA (0.8 , 1.0 , 1.25 mm pitch size), Chip Scale Package (0,5 mm pitch size) ve daha büyük paketli tüm devre dizgisi
  - Micro-D ve Nano-D, 38999 Serisi Konnektörler dahil olmak üzere her tür Wire to Board ve Board to Board konnektör montajı
- IPC Standartlarında kabul kriterleri belirtilmiş, kablolaj uygulamaları
  - D38999 konnektör kablolajı üretimi
  - Blendajlı ve shield'lı kablolaj üretimi
  - EMI test kablolajları üretimi
  - Cihaz içi kablolaj üretimi
- EMI/EMC uyumlu cihaz kutusu ve alt parçaları montajı
  - Shock absorber montajı
  - Gasket, seal, o-ring montajı
  - D-ZUS montajı, vb.

### Production Activities

- **Electronic Component Assembly per IPC Standards DIP, SMD, BGA etc.**
  - 0402, 0603, 0805 and larger Chip Resistors and Capacitors
  - QFN, QFP, TQFN, TQFP, BGA (0.8 , 1.0 , 1.25 mm pitch size), Chip Scale Package (0,5 mm pitch size)
  - Micro-D and Nano-D, 38999 and all type Wire to Board ve Board to Board connector assembly
- **Harness per IPC Standards**
  - D38999 Series Connector and Harness Assembly
  - Shielded Harness Assembly
  - EMI Test Harness assembly
  - In-case Harness Assembly
- **EMI/EMC Compatible Device Box Design and Assembly**
  - Shock absorber mount
  - Gasket, seal, o-ring mount
  - D-ZUS mount etc.